

集成电路产业技术创新联盟

关于组织评选第三届“集成电路产业技术创新奖”的通知

各有关单位：

为鼓励集成电路技术创新、加强产业链合作、加速创新成果产业化，营造集成电路全产业链合作发展的良好局面，集成电路产业技术创新联盟（“大联盟”）拟举办第三届“集成电路产业技术创新奖”（“IC创新奖”）评选活动。

IC创新奖重点鼓励集成电路技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现大联盟倡导全产业链合作的理念。为此共设立技术创新奖、成果产业化奖、产业链合作奖以及产业创新突出贡献奖等四个奖项。

参加评选的单位填写第三届集成电路产业技术创新奖申报表（附件1），由单位负责人签字并加盖公章后，于11月30日前将纸质材料原件一式一份快递至大联盟秘书处，同时将电子版申报表（Word版和PDF扫描版）发送至秘书处联系人邮箱。

具体详见附件：

- 1、第三届集成电路产业技术创新奖实施方案
- 2、附件1-第三届集成电路产业技术创新奖申报表
- 3、附件2-历届集成电路产业技术创新奖获奖名单

联系人：李振山

电 话：010-82997023

手 机：13810428215

邮 箱：lizhenshan@ictia.cn

地 址：北京市朝阳区北土城西路3号中科院微电子所

集成电路产业技术创新联盟

2019年11月4日